(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-171937

(43)公開日 平成9年(1997)6月30日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01G 4/12	358		H 0 1 G 4/12	358
C 0 4 B 35/46			H 0 1 B 3/12	303
H 0 1 B 3/12	303		C 0 4 B 35/46	D

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 12 頁)

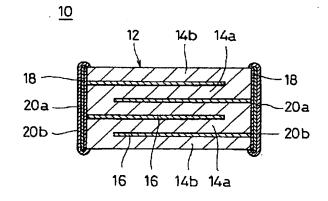
		一番重明水 木明水 明水丸の数4 FD(主 12 月	ŧ)
(21)出願番号	特願平7-349732	(71)出願人 000006231	
(00) III E P	77 - N = 1- (100F) 10 F100 W	株式会社村田製作所	
(22)出顧日	平成7年(1995)12月20日	京都府長岡京市天神二丁目26番10号	
		(72)発明者 坂 本 巌 彦	
		京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株	式
		会社村田製作所内	
		(72)発明者 佐 野 晴 信	
		京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株	式
		会社村田製作所内	- •
		(72)発明者 和 田 博 之	
		京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式	<u>_</u>
			D,
		会社村田製作所内	
		(74)代理人 弁理士 岡田 全啓	
		最終頁に続	<

(54)【発明の名称】 積層セラミックコンデンサ

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 低酸素分圧であっても半導体化せずに焼成可能で、誘電率及び絶縁抵抗が高く、高電界強度下における絶縁抵抗の低下率が低く、誘電体厚みを薄くしても信頼性に優れ、高温負荷、耐湿負荷等の耐候性能に優れた、小型大容量の積層セラミックコンデンサを提供する。

【解決手段】 誘電体セラミック層14a, 14bが、 $(1-\alpha-\beta)$ {BaO} 、 $TiO_2 + \alpha$ { $(1-x)M_2O_3 + xRe_2 O_3$ } + β ($Mn_{1-y-z} Ni_y Co_z$) O (0.0025 \leq α \leq 0.025、0.0025 \leq β \leq 0.05、 β / α \leq 4、0 < x \leq 0.50、0 \leq y < 1.0、0 \leq z < 1.0、0 \leq y + z < 1.0、1.000 < m \leq 1.035) で表される主成分10 モルに対して、副成分がM g Oを0.5 \sim 5.0 モル含有し、上記成分を100重量部として、Li20 (Si, Ti)O2 - Al2O3 - ZrO2系の酸化物を0.2 \sim 0.3重量部含有した材料によって構成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の誘電体セラミック層、

それぞれの端縁が前記誘電体セラミック層の両端面に露 出するように前記誘電体セラミック層間に形成された複 数の内部電極、および露出した前記内部電極に電気的に 接続されるように設けられた外部電極を含む積層セラミ ックコンデンサにおいて、

前記誘電体セラミック層が、

不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量が 0.02重量%以下のチタン酸バリウムと、

酸化スカンジウム、酸化イットリウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジスプロシウム、酸化マンガン、酸化コバルトおよび酸化ニッケルとからなり、次の組成式

 $(1-\alpha-\beta)$ {BaO}_a · TiO₂ + α { (1-x) M₂ O₃ +x Re₂O₃ } + β (M n_{1-y-z} Ni_y Co_z) O

(ただし、 Re_2 O_3 は、 Gd_2 O_3 、 Tb_2 O_3 、 Dy_2 O_3 の中から選ばれる一種類以上であり、 M_2 O_3 は、 Sc_2 O_3 、 Y_2 O_3 の中から選ばれる一種類以上であり、

 α , β , m , x , y , z l d ,

 $0.0025 \le \alpha \le 0.025$

 $0.0025 \le \beta \le 0.05$

 $\beta / \alpha \leq 4$

 $0 < x \le 0.50$

 $0 \le y < 1.0$

 $0 \le z < 1.0$

 $0 \le y + z < 1.0$

1.000<m≤1.035)

で表される主成分100モルに対して、

副成分として、酸化マグネシウムをMgOに換算して、 0.5~5.0モルを添加含有し、

さらに、上記成分を100重量部として、 Li_2 O- (Si, Ti) O_2 $-Al_2$ O_3 $-ZrO_2$ 系の酸化物を $0.2\sim3.0$ 重量部含有した材料によって構成され、

前記内部電極はニッケルまたはニッケル合金によって構成されていることを特徴とする、積層セラミックコンデンサ、

【請求項2】 前記L i_2 O \cdots (Si, Ti) O $_2$ -A l_2 O $_3$ -ZrO $_2$ 系の酸化物が、{L i_2 O $_1$ (Si w T i_{1-w}) O $_2$, M} (ただし、0.30 \le w \le 1.0、MはA l_2 O $_3$ およびZrO $_2$ から選ばれる少なくとも1種類)の三角図としたときに(モル%で示す)、

A(20,80,0)

B(10,80,10)

C(10, 70, 20)

D(35, 45, 20)

E(45, 45, 10)

F(45, 55, 0)

(ただし、直線A-F上の組成の場合は0.3≦w<1.0)の6点を結ぶ6本の直線で囲まれた組成範囲にあることを特徴とする、請求項1に記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項3】 外部電極は、導電性金属粉末またはガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層によって構成されていることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の積層セラミックコンデンサ。

【請求項4】 外部電極は、導電性金属粉末またはガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層からなる第1層と、その上のメッキ層からなる第2層とからなる、請求項1または請求項2に記載の積層セラミックコンデンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、電子機器に用いられる積層セラミックコンデンサ、特に、ニッケルまたはニッケル合金からなる内部電極を有する積層セラミックコンデンサに関する。

[0002]

【従来の技術】BaTiO₃を主成分とする従来の誘電体材料を積層セラミックコンデンサに用いた場合、中性または還元性の低酸素分圧下で焼成すると還元され、半導体化を起こすという問題点があった。したがって、内部電極としては、誘電体磁器材料の焼結する温度下でも溶融することなく、かつ誘電体磁器材料を半導体化させない高酸素分圧下で焼成しても酸化することのない貴金属を用いる必要があった。このように、積層セラミックコンデンサの内部電極として、たとえばパラジウム、白金等の貴金属を用いる必要があるため、製造される積層セラミックコンデンサの低コスト化の大きな妨げとなっていた。

【0003】そこで、上述の問題点を解決するために、 たとえばニッケル等の安価な卑金属を内部電極材料とし て使用することが望まれていた。しかし、このような卑 金属を内部電極材料として使用し、従来の条件下で焼成 すると、電極材料が酸化されてしまい、電極としての機 能を果たさなくなってしまう。そのため、このような卑 金属を内部電極として使用するためには、酸素分圧の低 い中性または還元性の雰囲気で焼成しても磁器材料が半 導体化することなく、十分な比抵抗と優れた誘電特性と を有する積層セラミックコンデンサが望まれていた。こ れらの条件を満たす材料として、たとえば特開昭62-256422号に開示されているBaTiO₃-CaZ rO₃ -MnO-MgO系の組成や、特開昭63-10 3861号に開示されているBaTiO₃-MnO-M g〇-希土類酸化物系の組成や、あるいは特公昭61-14610号に開示されている $BaTiO_3$ - (Mg, Zn, Sr, Ca) O-Li₂ O-SiO₂ -MO(M

O:BaO, SrO, CaO) 系の組成等が提案されて きた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開昭 62-256422 号に開示されている非還元性誘電体 磁器組成物では、 $CaZrO_3$ や焼成過程で生成する $CaTiO_3$ が、Mn等とともに異相を生成しやすいた め、高温における信頼性の低下につながる危険があった。

【0005】また、特開昭63-103861号に開示されている非還元性誘電体磁器組成物では、絶縁抵抗および容量の温度変化率が主成分である $BaTiO_3$ の結晶粒径に大きく影響を受け、安定した特性を得るための制御が困難である。さらに、絶縁抵抗も静電容量との積(CR積)で示した場合、 $1000\sim2000$ (Ω ・F)であり、実用的であるとは言い難い。

【0006】さらに、特公昭61-14610号等に開示されている非還元性誘電体磁器組成物では、得られる誘電体の誘電率が2000~2800であり、Pd等の費金属を使用している従来の誘電体磁器組成物の誘電率である3000~3500と比較すると劣っている。したがって、この組成物をコストダウンのために、そのまま従来の材料と置き換えるのは、コンデンサの小型大容量化という点で不利であり、問題点が残されていた。

【0007】さらに、これまでに提案されている非還元 性誘電体磁器組成物では、室温での絶縁抵抗は高いもの の、高温下において著しく抵抗値が低下する傾向があっ た。この傾向は、特に高電界強度下において顕著であっ たため、誘電体層の薄層化を行う場合に大きな障害とな っていた。そのため、非還元性誘電体磁器組成物を用い た薄層の積層コンデンサは実用化に至っていなかった。 また、これらの非還元性誘電体磁器組成物は、Pd等を 内部電極とする従来の材料と比較して、高温・高湿下に おける信頼性(いわゆる耐湿負荷特性)についても劣る という欠点を有していた。本願発明者等は、これまで に、非還元性誘電体磁器組成物として、特開平05-0 09066~009068号等に、上記の問題点を解決 すべく新たな組成を提案してきた。しかし、その後の市 場の要求特性、特に高温、高湿下で要求される特性がよ り厳しくなったことから、さらに特性の優れた組成を提 案する必要が生じてきた。

【0008】それゆえに、この発明の主たる目的は、低酸素分圧であっても半導体化することなく焼成可能であり、かつ誘電率が3000以上、絶縁抵抗が静電容量との積(CR積)で示した場合に6000Ω・F以上であり、高電界強度下における絶縁抵抗の低下率が低く、誘電体厚みを薄くしても信頼性に優れて定格電圧も高く、静電容量の温度特性がJIS規格で規定するB特性及びEIA規格で規定するX7R特性を満足し、さらには、高温負荷、耐湿負荷等の耐候性能に優れた、小型大容量

の積層セラミックコンデンサを提供することである。【0009】

【課題を解決するための手段】この発明は、複数の誘電 体セラミック層と、それぞれの端縁が誘電体セラミック 層の両端面に露出するように誘電体セラミック層間に形 成された複数の内部電極、および、露出した内部電極に 電気的に接続されるように設けられた外部電極を含む積 層セラミックコンデンサにおいて、誘電体セラミック層 が、不純物として含まれるアルカリ金属酸化物の含有量 が0.02重量%以下のチタン酸バリウムと、酸化イッ トリウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジ スプロシウム、酸化マンガン、酸化コバルトおよび酸化 ニッケルとからなり、次の組成式、 $(1-\alpha-\beta)$ {B aO_m · TiO₂ + α { (1-x)M₂ O₃ + xRe $_{2}O_{3}$ } + β (M n_{1-y-z} N i_{y} C o_{z}) O (ただし、 $Re_2 O_3 id Gd_2 O_3 Tb_2 O_3 Dy_2 O_3 O$ 中から選ばれる一種類以上、M₂ O₃ はY₂ O₃ 、Sc $_2$ O_3 の中から選ばれる一種類以上、 α 、 β 、m、x、 y, zd, 0.0025≤ α ≤0.025, 0.002 $5 \le \beta \le 0.05$, $\beta / \alpha \le 4$, $0 < x \le 0.50$, 0 $\leq y < 1.0, 0 \leq z < 1.0, 0 \leq y + z < 1.0,$ 1.000<m≤1.035)で表される主成分100 モルに対して、副成分として、酸化マグネシウムをMg 〇に換算して0.5~5.0モル添加含有し、さらに、 上記成分を100重量部として、Li₂O-(Si, T i)O₂-A1,O₃-ZrO,系の酸化物を0.2~ 3. 0重量部含有した材料によって構成され、内部電極 はニッケルまたはニッケル合金によって構成される、積 層セラミックコンデンサである。

【 0010 】 Li_2 0- (Si, Ti) O_2 $-\text{Al}_2$ O_3 $-\text{ZrO}_2$ 系の酸化物は、{ Li_2 O, (Si, Ti_{1-w}) O_2 , M} (ただし、0. $30 \leq w \leq 1$. 0、M は Al_2 O_3 および ZrO_2 から選ばれる少なくとも 1 種類) の三角図としたときに(モル%で示す)、A(20、80、0)、B(10、80、10)、C(10、70、20)、D(35、45、20)、E(45、45、10)、F(45、55、0)、(ただし、直線 A-F上の組成の場合は 0. 00 の 00 点を結ぶ 00 本の直線で囲まれた組成範囲にあることが好ましい。

【0011】外部電極は、導電性金属粉末またはガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層によって構成されているのが好ましい。また、外部電極は、導電性金属粉末またはガラスフリットを添加した導電性金属粉末の焼結層からなる第1層と、その上のメッキ層からなる第2層とからなるのが好ましい。

[0012]

【発明の効果】この発明にかかる積層セラミックコンデンサは、中性または還元性の雰囲気中において1260~1300℃の温度で焼成しても、絶縁抵抗が静電容量

との積(CR積)で表した場合に6000Ω・F以上であるとともに、高電界強度下においてもその値の低下率が低く、誘電体厚みを薄くしても信頼性に優れて定格電圧も高く、3000以上の高誘電率を示し、静電容量の温度特性がJIS規格で規定するところのB特性及びEIA規格で規定するところのX7R特性を満足し、さらに高温,高湿下での特性劣下もない優れた特性を示す。【0013】したがって、この発明にかかる積層セラミックコンデンサは、内部電極としてニッケルまたはニッケル合金を用いることかできる。そのため、この発明によれば、従来のPd等の貴金属を用いたものと比較して、高温負荷、耐湿負荷特性等の耐候性能を含めた全ての特性を落とすことなく大幅なコストダウンを行うことが可能になる。

【0014】この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の発明の実施の形態および実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

[0015]

【発明の実施の形態】図1はこの発明の一実施例を示す 断面図である。この積層セラミックコンデンサ10は、 積層誘電体セラミック体12を含む。積層誘電体セラミ ック体12は、複数枚の第1の誘電体セラミック層14 aおよび2枚の第2の誘電体セラミック層14bを積層 することによって形成される。この積層誘電体セラミッ ク体12では、第2の誘電体セラミック層14bが両端 面に配置され、2枚の第2の誘電体セラミック層14b が複数枚の第1の誘電体セラミック層14aを挟み込む ように、誘電体セラミック層14a,14bが積層され る。これらの誘電体セラミック層14a,14bは、内 部電極16を介在して積層される。また、積層誘電体セ ラミック体12の両端面には、外部電極18,第1のメ ッキ被膜20aおよび第2のメッキ被膜20bがこの順 に形成される。第1のメッキ被膜20aとしては、ニッ ケル、銅などが用いられ、第2のメッキ被膜20bとし ては、半田、錫などが用いられる。すなわち、積層セラ ミックコンデンサ10は、直方体形状のチップタイプと なるように形成される。

【0016】次に、この発明にかかる積層セラミックコンデンサ10の製造方法について、製造工程順に説明する。

【0017】まず、積層誘電体セラミック体12が以下のように形成される。図2に示すように、チタン酸バリウムと、酸化イットリウム、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ジスプロシウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化ニッケルおよび酸化マグネシウムと、 $Li_2O-(TiO_2,SiO_2)-Al_2O_3$ とを主成分

とする酸化ガラスからなる材料粉末をスラリ化してシート状とした第1の誘電体セラミック層14a(グリーンシート)を用意し、その一面にニッケルまたはニッケル合金からなる内部電極16を形成する。なお、内部電極16を形成する方法は、スクリーン印刷などによる形成でもよいし、蒸着、メッキ法による形成でもよい。内部電極16が形成された第1の誘電体セラミック層14aは必要枚数積層され、図3に示す如く、内部電極16が形成されない第2の誘電体セラミック層14bにて挟んで圧着し、積層体とする。その後、この積層体を、還元性雰囲気中、所定の温度にて焼成し、積層誘電体セラミック体12が形成される。

【0018】次に、積層誘電体セラミック体12の両端 面に、内部電極16と接続するように、二つの外部電極 18が形成される。この外部電極18の材料としては、 内部電極16と同じ材料を使用することができる。ま た、外部電極18の材料としては、銀、パラジウム、銀 -パラジウム合金等が使用可能であるが、積層セラミッ クコンデンサ10の使用用途、使用場所などを考慮に入 れて、適当な材料が選択される。また、外部電板18 は、材料となる金属粉末ペーストを、焼成により得た積 層誘電体セラミック体12に塗布して、焼き付けること によって形成されるが、焼成前に塗布して、積層誘電体 セラミック体12と同時に形成してもよい。この後、外 部電極18上にニッケル、銅などのメッキを施し、第1 のメッキ被膜20 aが形成される。最後に、この第1の メッキ被膜20aの上に、半田、錫などの第2のメッキ 被膜20bが形成され、チップ型の積層セラミックコン デンサ10が製造される。

[0019]

【実施例】

(実施例1)まず、出発原料として種々の純度のTiC 1_4 $とBa(NO_3)_2$ $とを準備して秤量した後、蓚酸により蓚酸チタニルバリウム(BaTiO(<math>C_2O_4$)・ $4H_2O$)として沈澱させ、沈澱物を得た。この沈澱物を1000 C以上の温度で加熱分解させて、表1に示す4種類のチタン酸バリウム(BaTiO $_3$)を合成した。また、 $0.25Li_2O-0.65(0.30TiO_2\cdot0.70SiO_2)-0.10Al_2O_3$ (モル比)の組成割合になるように、各成分の酸化物、炭酸塩および水酸化物を秤量し、混合粉砕した後、蒸発乾燥して粉末を得た。この粉末をアルミナるつぼ中において、1300 C に加熱溶融した後、急冷し、粉砕することによって、平均粒径が1 μ m以下の酸化物ガラスを得た。【0020】

【表1】

BaTiO。の		不純物	含有量(重量%)		平均拉径
種類 A B	アルカリ金属酸化物	Sr0	CaO	SiO ₂	A1202	(μm)
A	0. 003	0.012	0.001	0.010	0.005	0. 60
В	0. 020	0. 010	0.003	0.019	0.008	0. 56
С	0.012	0.179	0.018	0. 155	0.071	0.72
D	0.062	0014	0.001	0.019	0. 004	0. 58

【0021】次に、チタン酸バリウムのBa/Tiモル比mを調整するための $BaCO_3$ と、純度99%以上の Sc_2O_3 、 Y_2O_3 、 Gd_2O_3 、 Tb_2O_3 、 Dy_2O_3 、 $MnCO_3$ 、NiO、 Co_2O_3 、MgOとを準備した。これらの原料粉末と酸化物ガラスとを表2に示す組成比となるように配合し、配合物を得た。この配合物に、ボリビニルブチラール系バイングおよびエタノール等の有機溶剤を加えて、ボールミルにより湿式混合

し、セラミックスラリーを調製した。このセラミックスラリーをドクタープレード法によってシート形成し、厚み 14μ mの矩形のセラミックグリーンシートを得た。次に、このセラミックグリーンシート上に、Niを主体とする導電ペーストを印刷し、内部電極を構成するための導電ペースト層を形成した。

[0022]

【表2】

盟			=	(l-a-B)	(BaO)		1, + a ((1-x)14201	+xRe ₃ C	•110, + α ((1-x)M ₂ 0, +xRe ₃ 0,) + β (M _{x1-,-,N} i, Co.			20				酸化物ガラスの
	B.Till O			2			98									\$€	松竹
番号	種	8	్త్రి	λ	1-x	8	2	Dy	×	84	B/ a	>	2	y + 2	6		(無量等)
*	A	0.000	<u>'</u>	'	1	,	١	'		0.0200		0.20	0.20	0.40	1.010	8	0.89
* 2	٧	0.0100	_	0.60	0.60	,	0, 40	,	0.40	0.0000	0		1	1	1. 010	F. 88	0.50
*	A	0.0150	<u>'</u>	1.00	I. 00	1	1	ı	0.00	0.0450	£	07.50	02.0	0.40	1.010	1.00	0.50
*	K	0.0100	6 83	0.60	08.0	,	1	0.20	0.20	0.0200	2	9.33 33	0.20	0.50	0.830	9.1	0.50
*	4	0.0200	0.20	0.70	0.90	ı	0 2:	1	9. 10	0.0200	-	e. 8	0.30	09.0	1.000	1.50	0.80
9	¥	0.0100	<u>'</u>	0.70	0.70	1	١	0.30	98	0,0300	3	0.20	0.20	0.40	1.010	0.30	0.80
1 *	A	0010.0	1	08.0	08.0	1	-	0.20	0. 20	0.0100	1	0.10	0.30	0, 40	1.010	9. 8	0.00
80	٧	0.0025	Ľ	0.80	0.80	ı	ı	0.20	0.20	0.0025	-	0.20	0.50	0.70	1.010	1.50	0.20
8	Ą	0.0250	0.23	0.70	06.0	1	ı	0. 10	0.10	0.0500	7	0.20	07 0	0.40	1.005	09.0	0.80
2	Ą	0900 0	Ľ	0.70	0.70	ı	O. 33	1	6. 8	0.0240	7	0.30	0.20	0.50	1.015	1.50	1.00
Ξ	Ą	0.0100	1	0.50	0.50	ı	0.50	ı	0.50	0.0025	9.25	0.10	0. 50	0.60	1.005	2.50	0.50
13	A	0900 0	9.8	i	09.0	0, 40	1	1	0.40	0.0090	1.5	0.80	0.00	0.80	1. 010	1.50	1.20
13	В	0010 0	1	06.0	06.0	Q. 10	ŧ	_	0. 10	0.0200	2	9.0	0.80	0.80	1.010	1.20	0.80
14	V	0.0040	<u>'</u>	0.80	08.0	0.10	-	0.10	0. 20	0.0080	7	0. 20	0.10	0.30	1.010	5.00	1.00
51	ပ	0510.0	!	0.70	0.70	-	07 '0	0.10	0.30	0.0300	2	0.00	0, 00	0.00	1.035	0.50	1.00
91	٧	0.0200	1	0.70	0.70	0.10	0, 10	0.10	0.30	0.0400	2	0.30	0.00	0.30	1.035	 S	3.00
¥ 17	A	0.0300	1	08.0	08.0	_		0.20	0.20	0.0300	-	9.50	0. 10	0.30	1.038	28	1.50
*18	Α	0.0200	1	0. 70	0.70	1	_	0.30	0.30	0.0700	3.5	0. 10	0. 20	o. %	1.010	1.00	1.00
61 *	Ą	0010 0	0.20	09.0	0.80	1	0.20	1	0.20	0.0500	5	0.30	0. 10	0.40	1.010	1.00	0.80
02 *	٧	0.0200	+	0.30	0.30	0.70	-	ı	0.70	0.0400	7	9.33 (3.33	Q 10	33	1.010	1.08	0.80
12 *	٧	0.0100	1	03.0	0.80	ı	_	0. 20	0.20	0.0100	1	1.00	9.00	8.	1.010	1.23	0.80
23 *	¥	0.0050		0.70	0.70	1	1	0.30	0.30	0.0100	2	0.00	1.80	1.00	1. 020	1.00	0.80
*23	٧	0.0050	02.00	09.0	0.80	02.0	ı	-	0.20	0.0100	2	0.50	0.50	1.00	1.030	1.00	0.80
*24	٧	0.0050	_	0.70	0.70	06.0	1	1	0.30	0.0100	2	0. 10	0. 10	0.33	1.050	1.00	0.80
*22	Ą	0.0050	0.2	0.70	0.30	ŀ	1	0. 10	0. 10	0.0100	2	0. 10	0. 10	o. 83	1.010	7.00	0.80
* 28	¥	0.0160	1	0.70	0.70	ı	ı	0.30	0.30	0.0040	8	o. 30	0. 20	0.40	1. 010	1.00	5.00
12*	D	0.0100	1	0.60	0.60	1	1	0,40	0.40	0.0300	9	0.30	0. 10	0.40	1.015	1.50	1.00

【0023】導電ペースト層が形成されたセラミックグリーンシートを導電ペーストの引き出されている側が互い違いとなるように複数枚積層し、積層体を得た。この積層体を、N2雰囲気中にて350℃の温度に加熱し、バインダを燃焼させた後、酸素分圧10-9~10-12 MPaのH2-N2-H2Oガスからなる還元性雰囲気中において表3に示す温度で2時間焼成し、セラミック焼

結体を得た。このセラミック焼結体の両端面に銀ペーストを塗布し、 N_2 雰囲気中において600Cの温度で焼き付け、内部電極と電気的に接続された外部電極を形成した。

[0024]

【表3】

*印はこの発明の範囲外

	, ——												の発明の範囲が			
	[度変化率		品度変化	红	CRM	(25°C)	CREE((125°C)	l			
試料	焼成	誘電率	娇電	ΔC,	/C10	Δ	C/C.,			· F)	1	· F)	平均寿	耐湿負荷		
			損失	()	6)		(%)		(30		\		命時間	試験での		
番号	温度	£	ian ô	-25°C	85 °C	- 55 °C	125°C	CLAX	16V	160V	16V	1600	(h)	不良数		
1 .	(3)		(%)	-20 C	83 C	- 33 C	123 0	ua.x	107	1007	150	1007				
* 1	1280	2830	3.1	-4.8	18.0	- 10. 6	13. 2	25. 3	6100	2030	2140	510	52	0/72		
* 2	1300					半導	体化	のた	め瀬	定 不	能		_			
* 3	1280	3360	20	0. 1	- 7.5	- 0, 4	- 8.9	8.9	6980	2970	2740	710	352	0/72		
* 4	1280					半導	体 化	o t	め)測	定不	能					
* 5	1280	3280	2.2	-0.1	- 9.5	- 0.5	-10.5	10. 5	4500	690	1520	350	229	0/72		
* 6	1280	3510	2.3	1.4	-14.6	1. 1	<u>-17.9</u>	19. 3	4100	1510	1480	390	235	0/72		
* 7	1350					焼箱	不足	のた	め)測	定不	能					
8	1280	3310	20	0.3	-10.0	- 0.5	-11.2	12.0	7250	2900	2540	660	575	0/72		
9	1280	3180	1.8	0.3	- 8.3	- 0.5	- 9.5	9. 6	6230	2500	2180	570	669	0/72		
10	1300	3250	1.6	0.5	- 9.1	- 0.3	-10.3	10. 5	7530	3010	2640	690	553	0/72		
11	1300	3020	1. 5	-0.3	- 7.3	- 1.1	- 8.5	8.5	6800	2720	2380	620	613	0/72		
12	1280	3280	1. 8	0. 2	- 8.6	- 0.6	- 9.3	9. 6	6280	2510	2200	570	663	0/72		
13	1300	3100	1. 6	0.1	- 7.3	- 0.7	- 8.5	8.5	7840	3140	2740	710	531	0/72		
14	1280	3150	1.7	-0.7	- 6.3	- 1.5	- 7.5	8. 0	6530	2610	2290	590	638 .	0/72		
15	1300	3260	1.9	-0.2	- 8.4	- 1.0	- 9.4	9. 5	6910	2760	2420	630	603	0/72		
16	1280	3350	1.5	1. 1	- 6.8	0.3	-12.3	12.5	7330	2930	2570	670	568	0/72		
*17	1350	2230	1.9	0.0	- 7.4	- 0.8	- 8.8	8. 6	4920	1600	1510	380	264	8/72		
*18	1300	3030	20	0.3	- 8.3	- 0.5	- 9. I	9.1	6100	1850	1630	460	363	0/72		
*19	1280	3520	2.1	1.5	-12.5	1.2	-18.9	20. 1	6020	2130	2030	530	531	0/72		
* 20	1300	3290	1. 9	1.3	-15.4	0.9	-17.3	18. 1	6840	2210	2310	590	611	0/72		
*2]	1300	3260	1. 8	0.2	- 9.6	- 0.2	-11.6	12.0	4630	1350	1210	360	210	0/72		
*22	1300	3180	1. 6	-0.2	- 7.8	- 1.0	~ 8.9	8. 9	4860	1210	1060	330	236	0/72		
* 23	1300	3320	2. 1	1.2	-10.0	0.5	-12.5	12.8	3950	1180	990	280	185	0/72		
*24	1350				13	き 桔 不	足(の た	め割	定 不 1	惟					
* 25	1350	2670	1. 3	-0.5	- 6.4	- 1.4	- 7.6	7. 6	5100	1690	1420	410	523	18/72		
*26	1260	2110	1. 8	1. 2	-12.6	0. 9	- 18. 5	18. 9	7020	2540	2360	580	567	0/72		
* 27	1280	2470	1. 7	0.6	- 5.1	0.5	- 6.3	6. 3	6950	2650	2320	540	506	0/72		

【0025】このようにして得られた積層コンデンサの外形寸法は、幅;1.6mm、長さ;3.2mm、厚さ;1.2mmであり、内部電極間に介在される誘電体セラミック層の厚みは 8μ mであった。また、有効誘電体セラミック層の総数は19であり、一層当たりの対向電極の面積は2.1mm²であった。

【0026】静電容量(C)および誘電損失(tan る)は、自動ブリッジ式測定器を用いて、周波数1KH z、1Vrms、温度25℃にて測定し、静電容量から誘電率(e)を算出した。次に、絶縁抵抗(R)を測定するために、絶縁抵抗計を用い、温度25℃および125℃にて16Vおよび160Vの直流電圧を2分間印加して絶縁抵抗(R)を測定し、静電容量(C)と絶縁抵抗(R)との積、すなわちCR積を求めた。また、温度変化に対する静電容量の変化率を測定した。

【0027】なお、温度変化に対する静電容量の変化率については、20℃での静電容量を基準とした-25 と85℃での変化率(Δ C/C $_{20}$)と、25℃での静電容量を基準とした-55℃と125℃での変化率(Δ C/C $_{25}$)および-55℃~125℃の範囲内で絶対値としてその変化率が最大である値($|\Delta$ C|max)を示

した。

【0028】また、高温負荷寿命試験として、各試料を36個ずつ、温度150℃にて直流電圧を100V印加して、その絶縁抵抗の経時変化を測定した。なお、高温負荷寿命試験は各試料の絶縁抵抗値(R)が106 Ω以下になったときの時間を寿命時間とし、その平均寿命時間を示す。耐湿負荷試験は、各試料を72個ずつ、2気圧(相対湿度100%)、温度121℃にて直流電圧を16V印加した場合において、250時間経過するまでに絶縁抵抗値(R)が106 Ω以下になった試料の個数を示す。

【0029】以上の結果を表3に示した。

【0030】表1、表2、表3から明らかなように、この発明の積層コンデンサは、誘電率をが3,000以上と高く、誘電正接tanδは2.5%以下で、温度に対する静電容量の変化率が、-25℃~85℃での範囲でJIS規格に規定するB特性規格を満足し、-55℃と125℃での範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。

【0031】しかも、16Vおよび160Vで25℃に おいて測定した絶縁抵抗は、CR積で表したときに、そ れぞれ6,000Ω・F、2,000Ω・F以上と高い値を示す。16 Vおよび160 Vで125℃において測定した絶縁抵抗も、CR積で表したときに、それぞれ2,000Ω・F、500Ω・F以上と高い値を示す。また、平均寿命時間が500時間以上と長い上に、耐温負荷試験においても不良の発生は認められない。さらに、焼成温度も1300℃以下と比較的低温で焼結可能である。

【 0 0 3 2 】ここで、この発明の組成限定理由について 説明する。

【0033】 $(1-\alpha-\beta)$ {BaO} $_{n}$ · TiO $_{2}$ + α {(1-x) M $_{2}$ O $_{3}$ + x Re $_{2}$ O $_{3}$ } + β (Mn $_{1-y-2}$ Ni $_{y}$ Co $_{z}$) O (ただし、Re $_{z}$ O $_{3}$ は、Gd $_{z}$ O $_{3}$ 、Tb $_{z}$ O $_{3}$ 、Dy $_{z}$ O $_{3}$ の中から選ばれる一種類以上、M $_{z}$ O $_{3}$ は、Y $_{z}$ O $_{3}$ 、Sc $_{z}$ O $_{3}$ の中から選ばれる一種類以上)における限定理由について、まず述べる。

【0034】試料番号1のように、 $(M_2 O_3 + Re_2 O_3)$ 量 α が0.0025未満の場合、誘電率 ϵ が3,000以下と低く、また、誘電正接 $\tan \alpha$ が2.5%を越え、静電容量の温度変化率も大きくなり、さらに、平均寿命時間が極端に短くなり、好ましくない。また、試料番号17のように、 $(M_2 O_3 + Re_2 O_3)$ 量 α が0.025を超えると、誘電率が3,000を超えず、絶縁抵抗が低下し、平均寿命時間が短くなり、また、焼結温度が高くなり、耐湿負荷試験において不良が発生し、好ましくない。

【0035】試料番号2のように、(Mn, Ni, Co) ○量βが0.0025より小さくなると、還元性雰囲気で焼成したとき磁器が還元され、半導体化して絶縁抵抗が低下してしまい、好ましくない。また、試料番号18のように、(Mn, Ni, Co) ○量βが0.05を超えると、160 V印加時および125℃における絶縁抵抗が低く、平均寿命時間が500時間よりも短くなり、好ましくない。さらに、試料番号21,22,23のように、Mnを全く含まない場合、絶縁抵抗が低下し、平均寿命時間が500時間よりも短くなり、好ましくない。

【0036】試料番号3のように、 $\{(1-x)M_2O_3+xRe_2O_3\}$ のxの値が0の場合、平均寿命時間が500時間よりも短くなり、好ましくない。また、試料番号20のようにxの値が0.5を超えると、静電容量の温度変化率が大きくなり、JIS規格のB特性およびEIA規格のX7R特性を満足しなくなり、好ましくない。

【0037】試料番号19のように、 $(M_2 O_3 + Re_2 O_3)$ 量 α と (Mn, Ni, Co) O量 β との比率 β / α が4よりも大きくなると、静電容量の温度変化率が大きくなり、好ましくない。

【0038】試料番号4,5のように、モル比mが1.000以下であると、半導体化したり、あるいは絶縁抵抗が低く、平均寿命時間が500時間よりも短くなり、好ましくない。また、試料番号24のように、モル比mが1.035を超えると、1350℃でも焼結しなくなり、好ましくない。

【0039】試料番号6のように、MgO量が0.5モル未満の場合、160 V印加時の絶縁抵抗(CR積)が2000 Ω ・Fを越えず、平均寿命時間が500時間よりも短くなり、静電容量の温度変化率がJIS規格のB特性およびEIA規格のX7R特性規格を満足せず、好ましくない。また、試料番号25のように、MgO量が5.0モルを超えると、焼結温度が高くなり、誘電率が3,000を越えず、絶縁抵抗が低下し、耐湿負荷試験において不良が発生し、好ましくない。

【0040】試料番号7のように、酸化物ガラスの量が 0.2重量部未満の場合、1350℃でも焼結しなくな り、好ましくない。また、試料番号26のように、酸化 物ガラスの量が3.0重量部を超えて含まれると、誘電 率が低くなり、静電容量の温度変化率が大きくなり、好 ましくない。

【0041】試料番号27のように、チタン酸バリウムに不純物として含有されるアルカリ金属量が0.02重量部よりも大きくなると、誘電率の低下を生じ、好ましくない。

【0042】(実施例2)誘電体粉末として、表1のAのチタン酸バリウムを用いて、97.0 $\{BaO\}$ 1.010 · TiO2 +0.7Y2 O3 +0.3Dy2 O3 +0.6MnO+0.7NiO+0.7CoO(モル比)に対して、MgOが1.2モルになるように配合された原料を準備し、実施例1と同様の方法で作製された表4に示す平均粒径1 μ m以下の酸化物ガラスを添加して、実施例1と同様の方法で、内部電極と電気的に接続された銀からなる外部電極を形成した積層コンデンサを作製した。なお、ガラスの加熱溶融温度は、ガラスの組成に応じて1200 $\mathbb C$ ~1500 $\mathbb C$ の範囲で調整した。なお、作製した積層コンデンサの外形寸法などは、実施例1と同様である。

[0043]

【表4】

* 印はこの発明の範囲外

試 料	ガラス添加量		酸化物ガ	ラスの	成分	
番号	(重量%)	LizO	(Siw Tit-w)	w	Al 202	ZrO ₂
101	1. 00	20	80	0.3	0	0
102	1. 00	10	80	0.6	5	5
103	0. 80	10	70	0.5	20	0
104	0. 80	35	45	1.0	10	10
105	1. 50	45	45	0. 5	10	0
106	1. 50	45	55	0. 3	0	0
107	1.00	20	70	0.6	5	5
108	1.00	20	70	0.4	10	0
109	1.20	30	60	0.7	5	5
110	1. 20	30	60	0.8	10	0
111	2. 00	40	50	0.6	5	5
112	2. 00	40	50	0. 9	0	10
* 113	1.50	10	8 5	0.4	5	0
* 114	2. 00	5	75	0.6	10	10
* 115	1. 20	20	55	0.5	25	0
* 116	1.00	45	40	0.8	0	15
* 117	0.80	50	45	0, 7	5	0
118	1. 20	25	75	0.9	0	0
* 119	1. 50	25	75	1.0	0	0
120	1. 00	35	65	0.9	0	0
* 121	1. 50	35	65	1.0	0	0
* 122	1. 20	20	70	0. 2	0	10

【0044】そして、これらについて電気的特性を測定した。静電容量(C)および誘電損失($tan\delta$)は、自動ブリッジ式測定器を用いて周波数1KHz、1Vrms、温度25℃にて測定し、静電容量から誘電率

(ε)を算出した。次に、絶縁抵抗(R)を測定するために、絶縁抵抗計を用い、16Vおよび160Vの直流電圧を2分間印加して、25℃および125℃での絶縁抵抗(R)を測定し、静電容量(C)と絶縁抵抗(R)との積、すなわちCR積を求めた。また、温度変化に対する静電容量の変化率を測定した。

【0045】なお、温度変化に対する静電容量の変化率については、20℃での静電容量を基準とした-25℃と85℃での変化率(Δ C/C $_{20}$)と、25℃での静電容量を基準とした-55℃と125℃での変化率(Δ C/C $_{25}$)および-55℃と125℃の範囲内で絶対値と

してその変化率が最大である値($|\Delta C|$ max)を示した。

【0046】また、高温負荷寿命試験として、各試料を36個ずつ、温度150℃にて直流電圧を100V印加して、その絶縁抵抗の経時変化を測定した。なお、高温負荷寿命試験は各試料の絶縁抵抗値(R)が10⁶ Ω以下になったときの時間を寿命時間とし、その平均寿命時間を示す。耐湿負荷試験は、各試料を72個ずつ、2気圧(相対湿度100%),温度121℃にて直流電圧を16V印加した場合において、250時間経過するまでに絶縁抵抗値(R)が10⁶ Ω以下になった試料の個数を示す。

【0047】以上の結果を表5に示した。

[0048]

【表5】

ا بـ		恒	9			Ţ.,	Γ.				Ţ				_		<u> </u>		T-			Γ	Π	Γ	Г	1	Τ
範囲夕		所混負荷	は後での	不良数		0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72	0/72			22/72			0/72	6/72	0/72	12/72	7/72
の発明の範囲外		平均寿	命時間	(F)		823	524	607	633	581	230	8	264	539	귫	591	537			210			514	536	587	54	683
日はこの	(0,10	[3] [3]			1600	610	630	280	540	520	640	290	610	530	580	640	650			531			650	260	540	919	520
*	ž c		(3 1.)		166	2090	2180	2050	2130	2030	2240	2020	2120	2140	2410	2180	2460	霘	鹅	2230	貒	磊	2250	2190	2080	2030	2190
	(c)	<u>ر</u> د			 }	2360	2460	2310	2410	2210	2250	2280	2390	2420	2450	2250	2520	弘	定不	2310	记不	吊不	2490	2270	2290	2110	2200
	5	C K ((2) C) (3) C	(4.8)	-	 20	6740	. 040	999	6890	6320	6420	6510	6830	0169	0669	6430	7200	多	め渡	6540	め	あ.	7120	6480	6540	6040	6110
					×z	12.0	11.2	10.0	11.5	8.2	9.0	8.9	10.0	10.3	12.0	8.6	13.1	9 K	9 ¥	13.5 6	0 t	Ø 7:	10.5	13.0 6	9.8	13.5 6	12.4 6
	容量温度变化率	AC/C15	(%)	L	125 CE	- 10. 5	-11.2	- 9.9	- 10.8	- 7.8	- 8.5	- 8.9	- 9.5	-10.3	-11.6	- 8.4	-13.1	足	팑	-13.5	퍼	맹	-10.5	-12.5	9.6	-13.5	-12.4
	容量通	ΔC,	3	i	 က	-0.8	-0.2	-0.7	-0.1	-1.5	-1.2	-0.8	-0.2	-0.4	-0.2	-1.1	0.5	: 結 不	帮	-0.2	枯木	· 中	-1.1	-0.1	-0.9	0. İ	-0.2
	既(2)排	 C	(: : :	-8.5	-8.9	-7.8	-8.5	-5.9	-6.8	-7.5	-7.9	-8.2	-9.2	-7.6	-8.9	焼	報	-8.9	兹	盎	-8.6	-9.1	-8.2	-9.5	-8.7
	容量溫度変化率	AC/Cu	(%)	Ş	3	-0.2	0.1	-0.3	0.2	-0.8	-0.7	-0.2	· 0. 1	0.0	0.1	-0.3	1.1			0.2			-0.4	0.2	-0.3	0.3	0.1
		聚	散	tan 8	(%)	1.7	2.0	l. 6	1.1	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.9	1.5	2.0			1.7			1.7	1.9	1.9	2.0	1.8
		新電車		₩		3210	3350	3160	3280	3010	3060	3100	3250	3290	3330	3060	3430			3250			3120	3240	3260	3100	3040
		焼		温度	(Ç)	1300	1300	1300	1280	1260	1260	330	1280	1280	1280	1380	1260	1350	1350	1350	1350	1350	1300	1350	1300	1350	1350
		紅紅		梅		101	102	103	ই	135 25	8	107	108	801	011	==	112	*113	*114	*115	*116	*117	81	* 119	8	*121	*122

【0049】表4、表5から明らかなように、この発明の酸化物ガラスを添加含有した誘電体セラミック層から構成される積層コンデンサは誘電率 ϵ が3,000以上と高く、誘電正接 \tan 002.5%以下で、温度に対する静電容量の変化率が、-55Cと125 $\mathbb C$ での範囲内でEIA規格に規定するX7R特性規格を満足する。【0050】しかも、16Vおよび160Vで25 $\mathbb C$ において測定した絶縁抵抗は、CR積で表したときに、それぞれ6,000 Ω ·F、2,000 Ω ·F以上と高い値を示す。16Vおよび160Vで125 $\mathbb C$ Cにおいて測定した絶縁抵抗も、CR積で表したときに、それぞれ2,000 Ω ·F、500 Ω ·F以上と高い値を示す。

また、平均寿命時間が500時間以上と長い上に、耐湿 負荷試験においても不良の発生は認められない。さら に、焼成温度も1300℃以下と比較的低温で焼結可能 である。

【0051】これに対して、この発明のLi2 O-(Si, Ti)O2-Al2 O3-ZrO2 からなる酸化物について、{Li2O, (Sim Ti1-m)O2, M} (ただし、0.30 \leq w \leq 1.0、MはAl2O3 およびZrO2 から選ばれる少なくとも1種類)の図4に示す三角図としたときに、Li2Oが2O%、(Si, Ti)O2が8O%、MがO%の組成を示す点Aと、Li2Oが10%、(Si, Ti)O2が8O%、Mが10

%の組成を示す点Bと、Li₂Oが10%、(Si, T i) O₂ が 7 0 %、M が 2 0 % の 組成を示す点 C と、L i, Oが35%、(Si, Ti)O, が45%、Mが2 0%の組成を示す点Dと、Li₂ Oが45%、(Si, Ti)O₂が45%、Mが10%の組成を示す点Eと、 Li₂ Oが45%、(Si, Ti)O₂ が55%、Mが 0%の組成を示す点Fとを結ぶ6本の直線で囲まれた範 囲に限定したのは、この範囲外の組成であれば、試料番 号113~117のように焼結性が著しく低下したり、 焼結したとしても耐湿負荷試験において不良が発生する ためである。6本の直線で囲まれた範囲内であっても、 点A-F上の組成かつo=1.0の場合には、試料番号 119、121のように、焼結温度が高くなり、耐湿負 荷試験において不良が発生し、好ましくない。また、o の値が0.30未満の場合には、試料番号122に示す ように、焼結温度が高くなり、耐湿負荷試験において不 良が発生し、好ましくない。

【0052】なお、上記実施例では、チタン酸バリウムとして、蓚酸法により作製した粉末を用いたが、これに限定するものではなく、アルコキシド法あるいは水熱合成法により作製されたチタン酸バリウム粉末を用いてもよい。これらの粉末を用いることにより、本実施例で示した特性よりも向上することも有り得る。また、酸化イットリウム、酸化コバルト、酸化ニッケルなども、酸化物粉末を用いたが、これに限定されるものではなく、こ

の発明の範囲の誘電体セラミック層を構成するように配合すれば、アルコキシド、有機金属などの溶液を用いても、得られる特性を何ら損なうものではない。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例を示す断面図である。

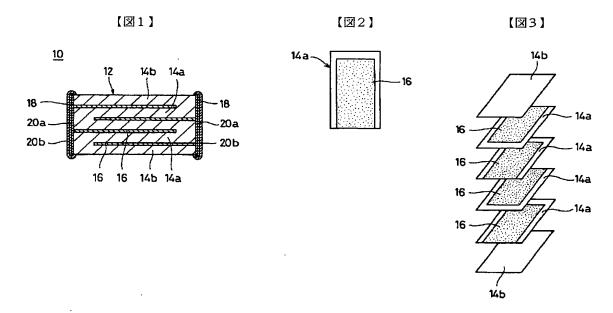
【図2】積層前の第1の誘電体セラミック層の一例を示す平面図である。

【図3】積層誘電体セラミック体を第1の誘電体セラミック層および第2の誘電体セラミック層を積層することによって形成する状態を示す分解斜視図である。

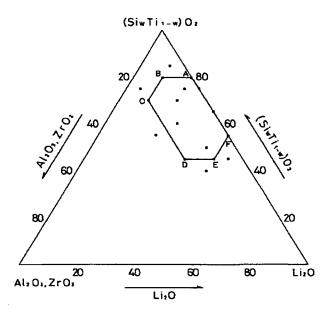
【図4】添加成分である Li_2 O-(Si, Ti)O₂- Al_2 O₃- ZrO_2 系の酸化物の組成範囲を示す { Li_2 O, (Si, Ti_{1-w})O₂, M} (Mは Al_2 O₃ および ZrO_2 から選ばれる少なくとも1種類)の3成分組成図である。

【符号の説明】

- 10 積層セラミックコンデンサ
- 12 積層誘電体セラミック体
- 14a 第1の誘電体セラミック層
- 14b 第2の誘電体セラミック層
- 16 内部電極
- 18 外部電極
- 20a 第1のメッキ被膜
- 20b 第2のメッキ被膜







フロントページの続き

(72)発明者 浜 地 幸 生 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式 会社村田製作所内